

# YDIV33-0208SC1

## 2-8GHz功分器 数据手册



四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

### 产品简介

YDIV33-0208SC1 型 GaAs 单片集成 0 度功分器，在 2~8GHz 的频率范围具有较低的插损和优良的端口驻波特性，隔离度大于 16dB，非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块。

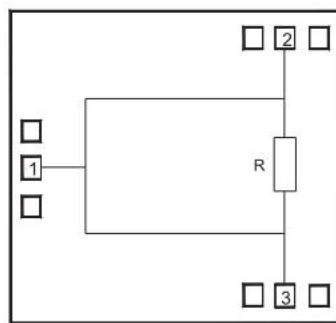
该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 工作频段：2 to 8 GHz
- 插入损耗： $\leq 0.9\text{dB}$
- 芯片尺寸：1.4mm x 0.8mm

### 应用领域

- 微波无线电
- 测试测量
- RF/微波电路
- 仪器仪表
- 军事和航天



YDIV33-0208SC1 功能框图



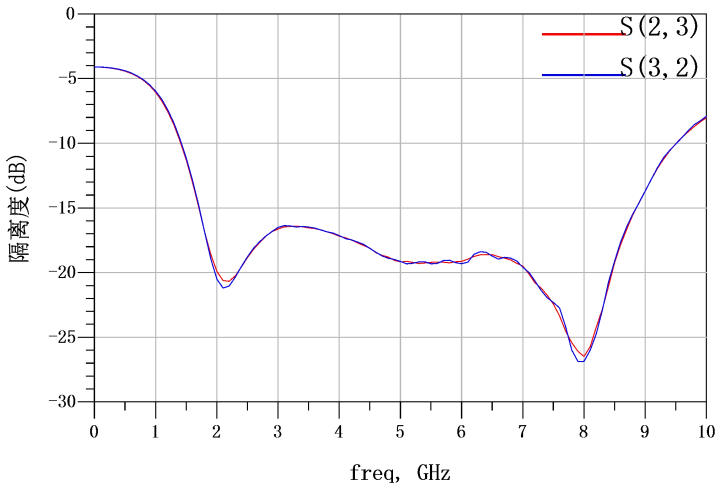
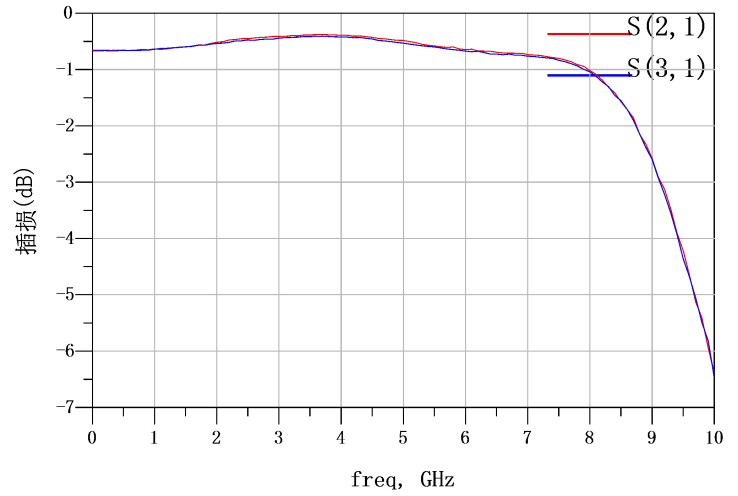
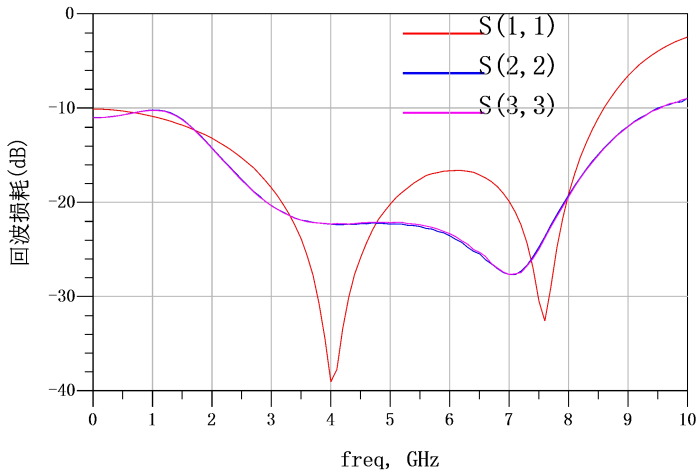
### 极限参数

储存温度	-65 ~ +150°C
工作温度	-55 ~ +125°C
结温	175°C
静电防护等级 (HBM)	Class1C

注意：高功率应用时，请采用共晶烧结工艺安装芯片。

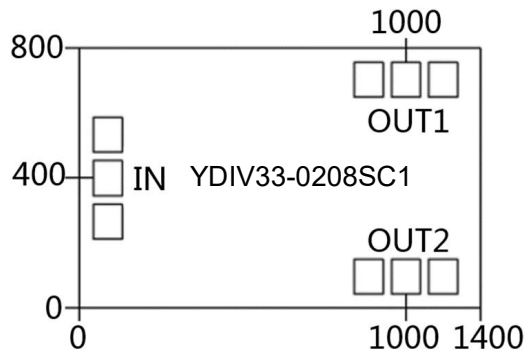
### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, 50 system)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2- 8			GHz
输入驻波	-	1.7	-	-
输出驻波	-	1.5	-	-
插入损耗	-	1.1	-	dB
隔离度	-	16	-	dB

**测试曲线**

**键合压点定义**

压点编号	功能符号	功能描述
1	IN	RF 输入端口, 阻抗 50
2、3	OUT1, OUT2	RF 输出端口, 阻抗 50
	GND	芯片背面必须接地

## 外形尺寸



说明：

1. 单位：微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金，压点尺寸：100x100 (um)
5. 不能在通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差：±50um

## 推荐装配图

